

旭鴻科技有限公司

SUNELITE TECHNOLOGY CO., LTD.



会社概要

旭鴻株式会社は、**2005年**の設立以来、プリント基板（**PCB**）の製造を主軸とした事業を展開しており、当社の製品は台湾国内をはじめ、日本やヨーロッパなど、広範な地域への輸出を通じ、多くのお客様のご支持をいただいております。

当社は、企業理念である「人を柱とする」を基に、多くの取引企業との信頼を築き上げてまいりました。確かな品質と切実な対応が当社の強みです。

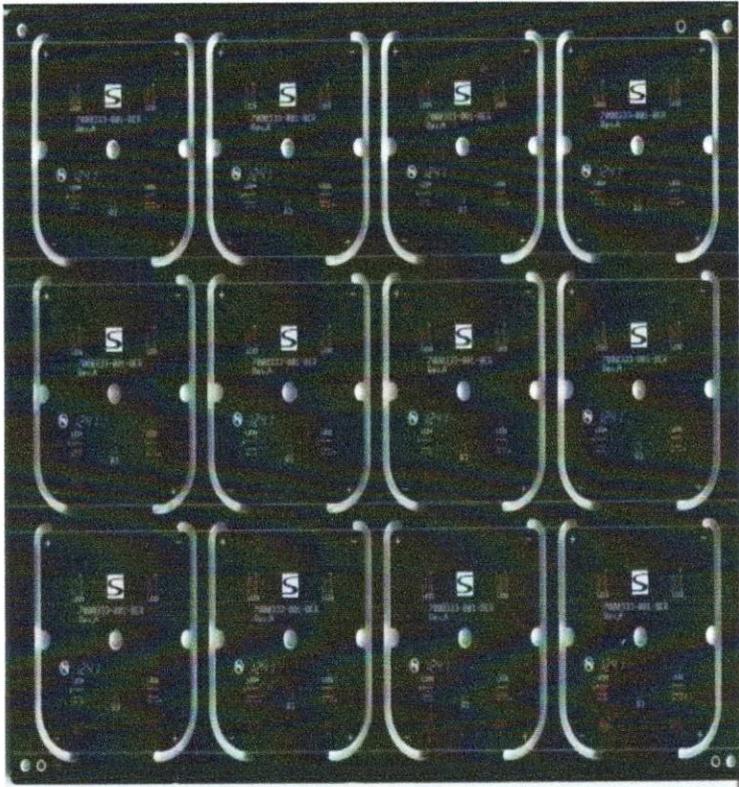
お客様のニーズに対して迅速な対応を実現するため、当社では製造拠点を台湾国内に集中させて製品品質の一括管理をしています。

また、品質管理の向上にも力を入れており、**2017年**は国際品質規格**ISO9001**の認証を取得、さらに、**2022年**には同規格を基盤とした**AS9100D**航空宇宙産業品質管理システムの認証を取得し、業界のトップレベルの品質を保証する体制を整えています。

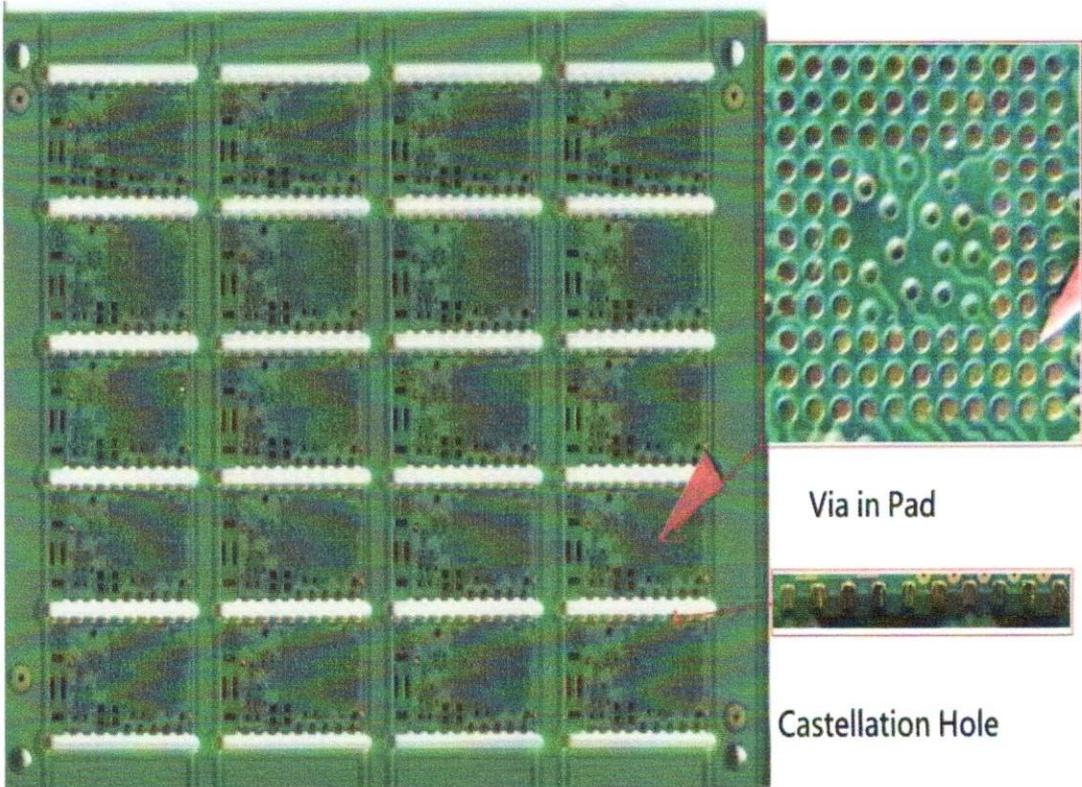
高品質な製品とサービスを提供し、日本のお客様との最良なビジネスパートナーをめざします。



製品紹介

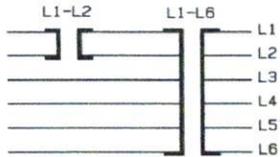


Metal core



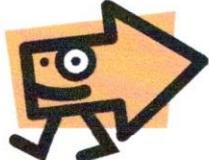
Via in Pad

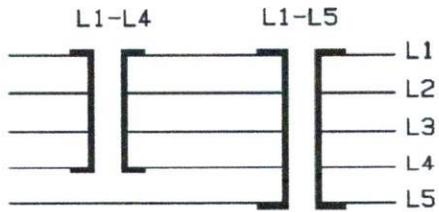
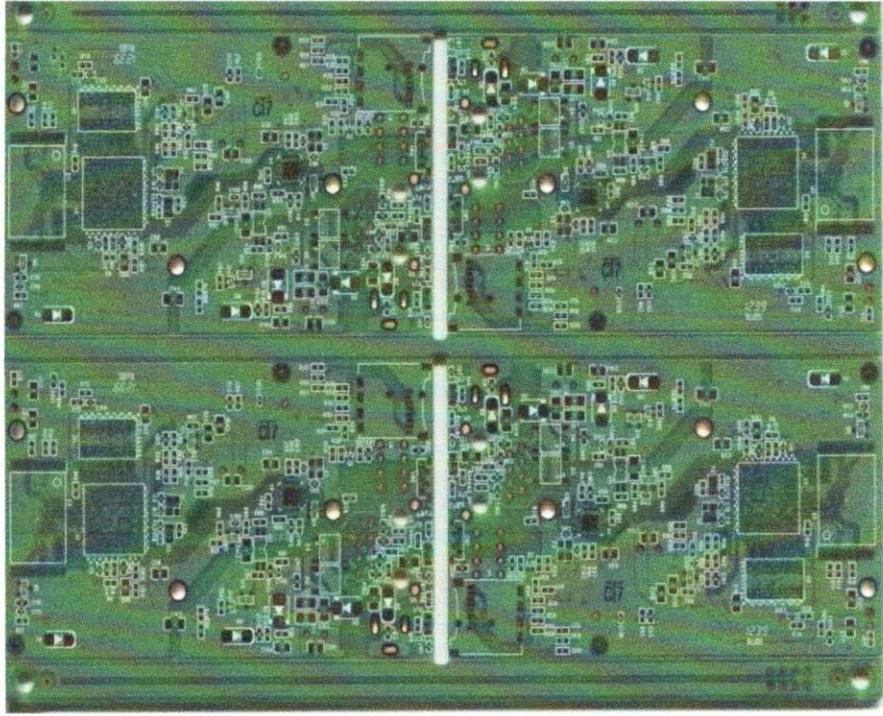
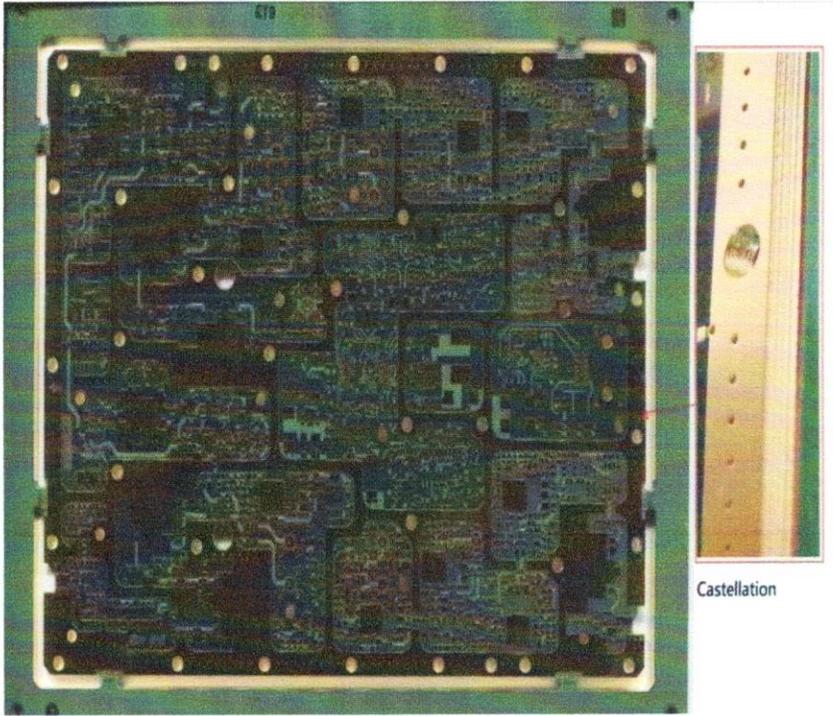
Castellation Hole



Via in Pad

Castellation Hole





5 Layers –
Blind Hole
Castellation

Impedance Controlled



生產能力

Process Step	Items	Capability
Material	FR-4 Material available Tg CEM-3-92 CEM-3-10	Tg 135°C, 150°C, 170°C, 180°C CEM-3-10→CTI 0
	Brand: NANYA	
	Copper foil (Inner / Outer)	Max. 4 OZ finished Min. 1/2 OZ
Special Material	Metal Core	Aluminum Max copper: 6oz
	ROGERS	RO4003C, RO4350, RO4360G2, RO3003, RT5880, Isoclad 917
Board Dimension	Working Panel size	Max. 450 mm x 650 mm
	Finished Thickness	Max. 3.2mm for MP, Min. 0.4mm (4 layers)
Inner layer	Trace / Spacing	Min. 4 / 4 mil for MP, 3 / 3 for sample
	Copper Weight	Min. 1/2 OZ Max. 3 OZ
	Core Thickness	Max. 2.0mm Min. 0.1mm

Process Step	Items	Capability
Lamination	Layer Count	Max. 16 Layer for MP, 22 Layers for sample Min. single layer
	Layer to Layer Registration	± 6mil
Drilling	Vias	Blind Vias Buried Vias Filled and capped
	Drill True Position	Tolerance ± 3 mil
	Drilling hole size	Min. 0.20mm
Plating	Aspect Ratio	1 : 6.4
	Copper Wall Thickness	≥0.8mil
Outer Layer	Trace / Spacing	Min. 4 / 4 mil
	Finished Trace Copper Thickness	Max. 4 OZ Min. 11mil
Surface Finished	HASL(Lead Free)	Max. 800μ" Min. 50μ"
	Immersion Gold(ENIG)	Max. 3 μ"
	Electrolytic Gold	Max. 30μ"
	Immersion Silver	Max. 25μ"
	OSP	Available
Solder Mask	Solder Mask Thickness	Max. 1.0 mil Min. 0.4 mil
	Solder Mask Dam Width	Min. 3mil
	Solder Mask Registration	± 2mil

Process Step	Items	Capability
Routing	Routing Width	Min. 30 mil
	V-cut Angle	Min. 30°
	V-cut Residual	Min. 8mil (0.20mm)
	Bevelling Gradient	Min. 25°
Test	SMT Pitch	Min. 10mil
	BGA Pitch	Min. 32mil
	Impedance Control	Tolerance $\pm 10\%$
	Differential Impedance Control	Tolerance $\pm 10\%$

お問い合わせをお待ちしております。

日本コンタクト

JAPAN: 宝智エレクトリック株式会社

Houchi Elec., Ltd

TEL: 080-3852-5108

担当: 舟崎(ふなさき)

メール: funasaki@houchi.jp

メーカーコンタクト

メーカー住所: No.34, Ln.81, Sanjun street, Shulin District,
New Taipei City 238, Taiwan

238 臺灣新北市樹林區三俊街81巷34號

TEL: +886-2-26880231

E-mail: jeff@sunelite.com.tw

Contact Person: Jeff Chen 陳振峯

URL: www.sunelite.com.tw